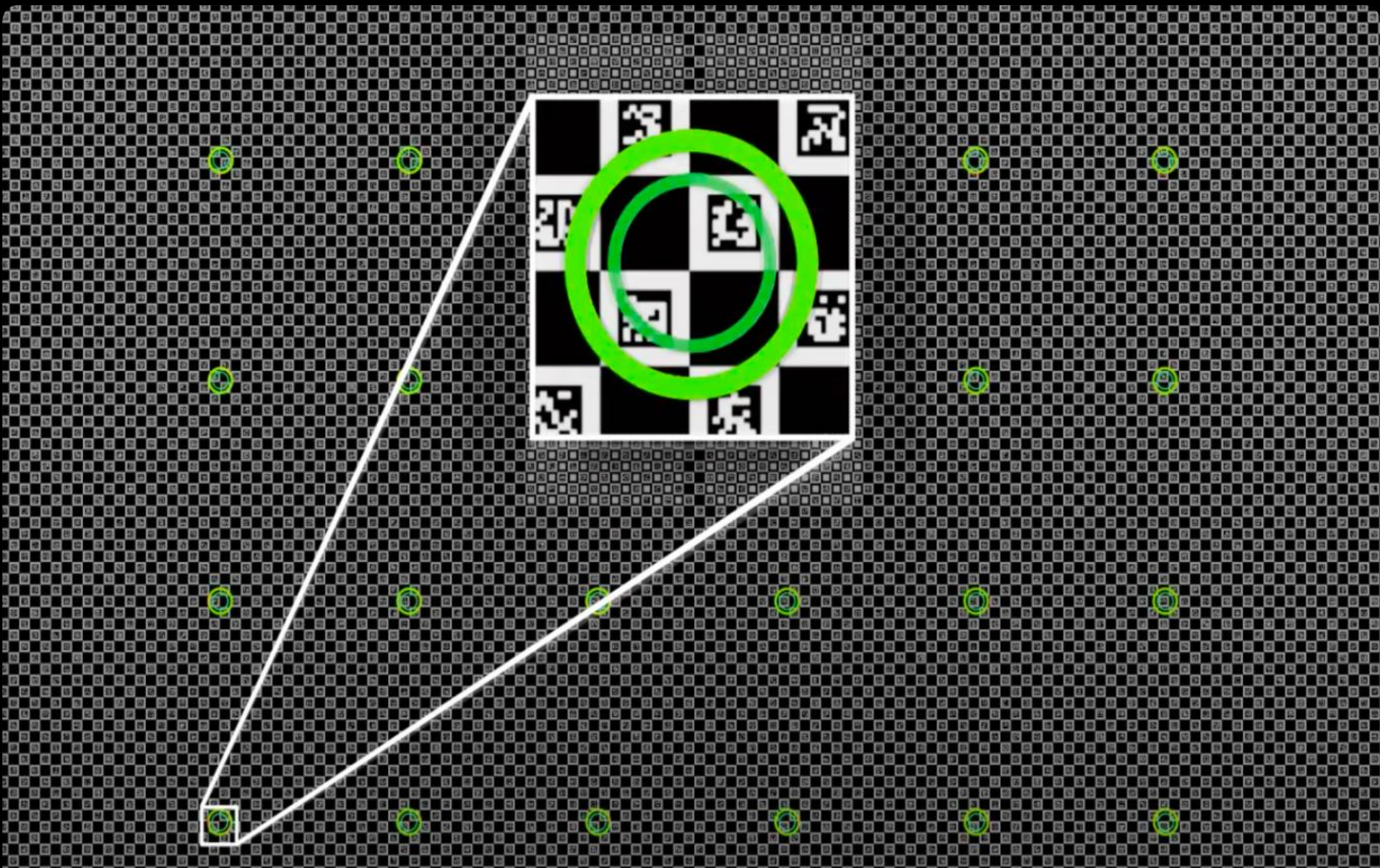
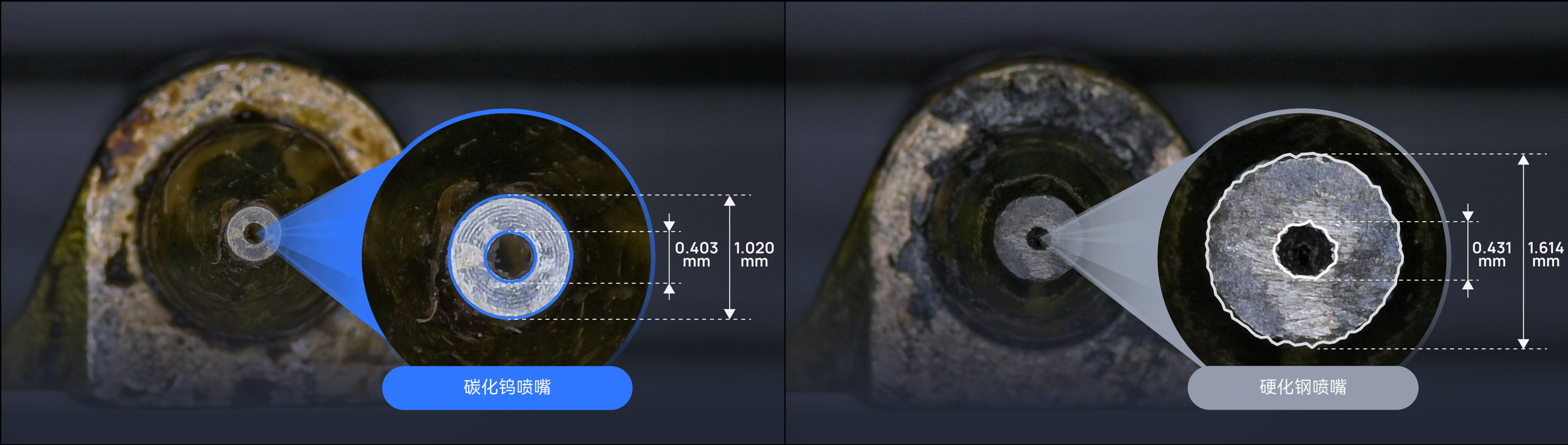


专业级高温双头 3D打印解决方案



碳化钨超耐用喷嘴

H2D Pro 的**碳化钨喷嘴**提供卓越的耐磨性，在打印磨蚀性、高性能纤维增强耗材时，可将**使用寿命延长 50%**。

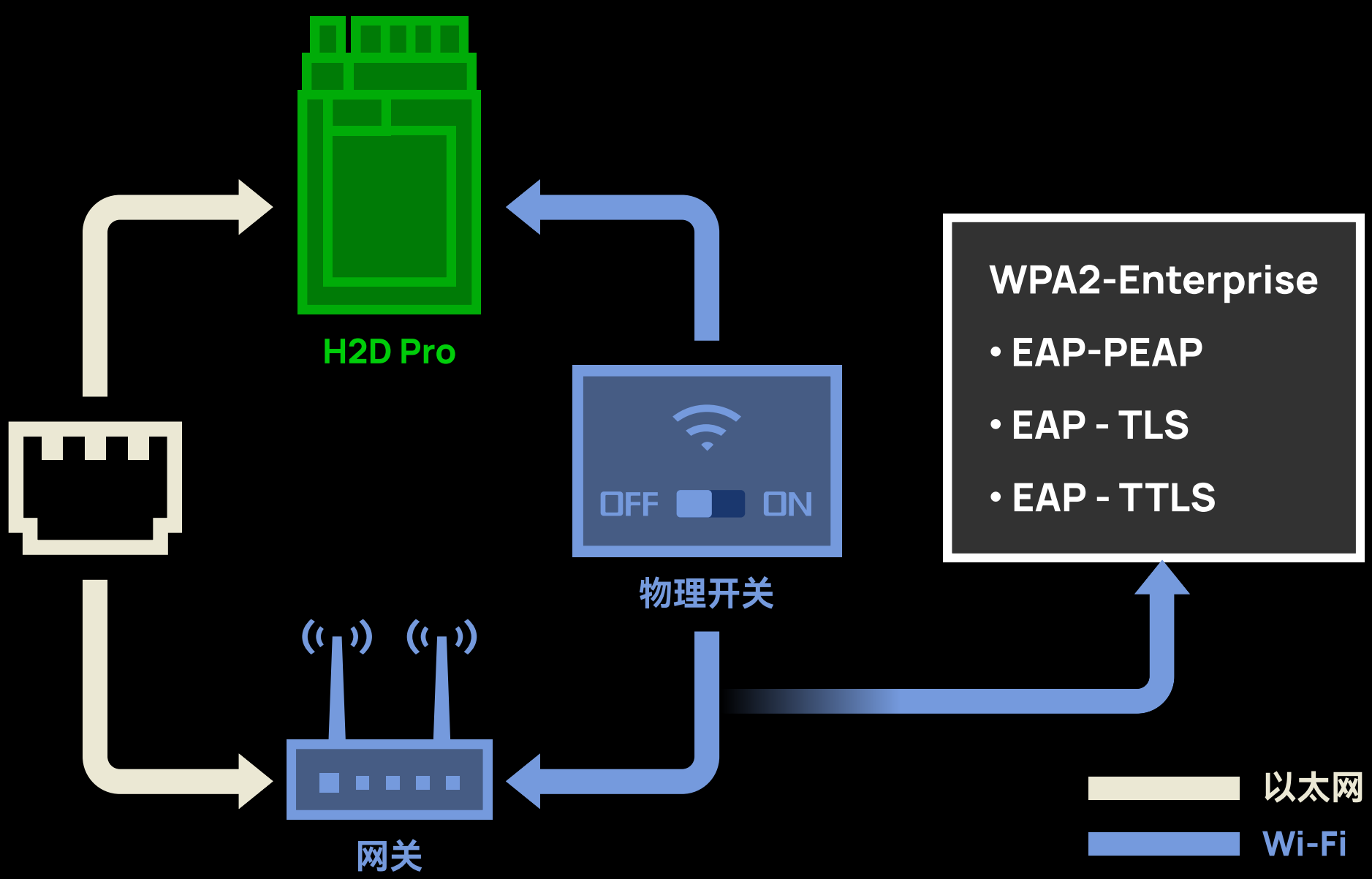


50微米超精细运动精度

H2D Pro 标配**视觉编码器板**，用于光学测量以校准工具头移动。这一先进系统确保在整个构建板上实现一致且与距离无关的**50微米运动精度**。

专业连接选项

H2D Pro 可通过**以太网端口**或 **WPA2-企业级 Wi-Fi 认证**（EAP-PEAP/EAP-TLS/EAP-TTLS）连接到您的设备，并配有独立的物理切断开关，满足严苛的网络安全要求。



高效空气过滤系统

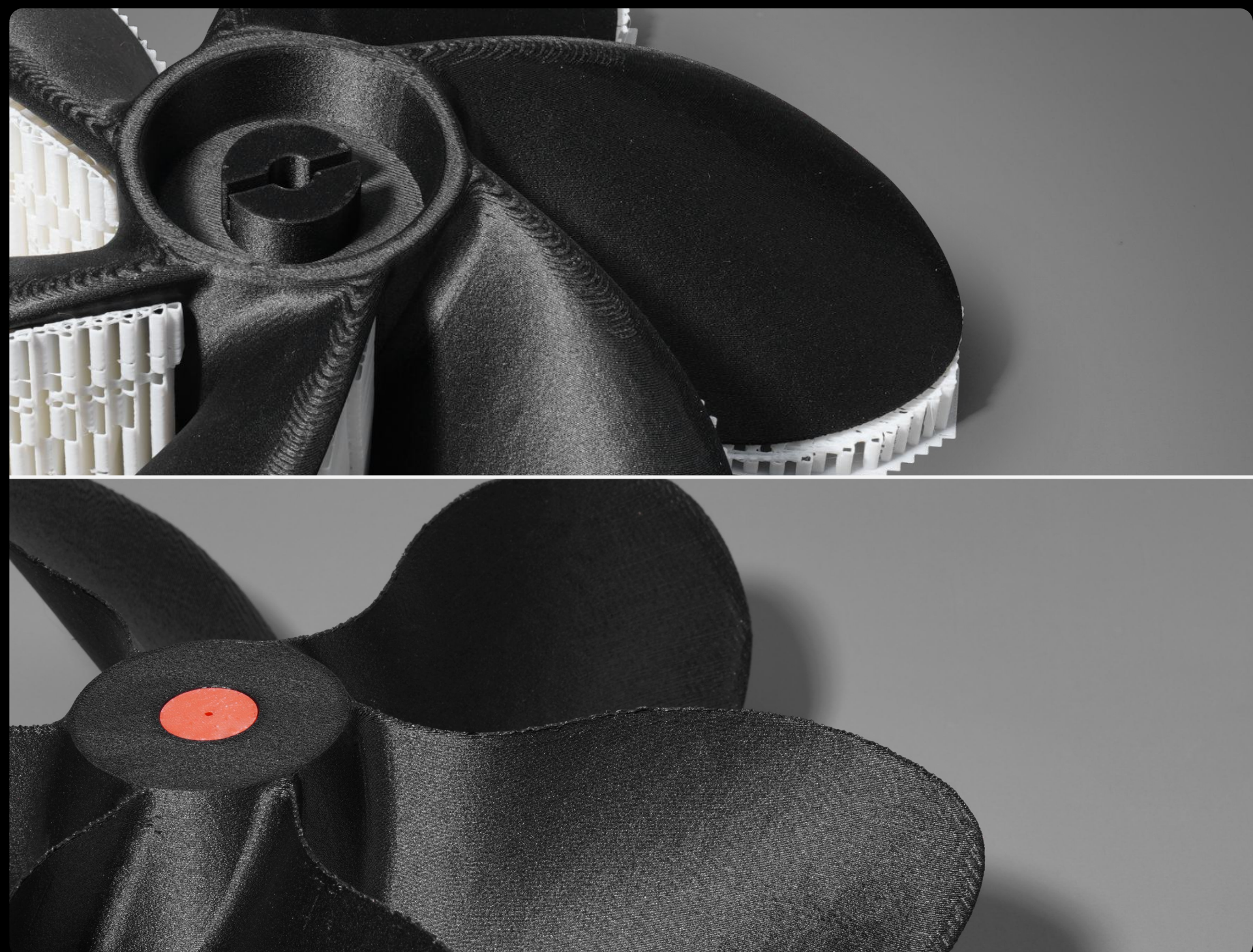
H2D Pro 的过滤系统集成了 **G3 初效过滤器**、**H12 HEPA 过滤器**和**优质椰壳活性炭过滤器**。有效最大限度地减少异味和颗粒物。

双喷嘴系统，效能提升利器

多材料打印

混搭柔性和刚性耗材、低成本和特殊耗材

在单次打印中，结合柔性和刚性耗材，创造出令人叫绝的互锁结构和超越传统的创新设计。合理搭配高性能耗材与普通耗材，仅在必要时使用高性能耗材，降低打印成本、提高耗材效率。



专用支撑耗材

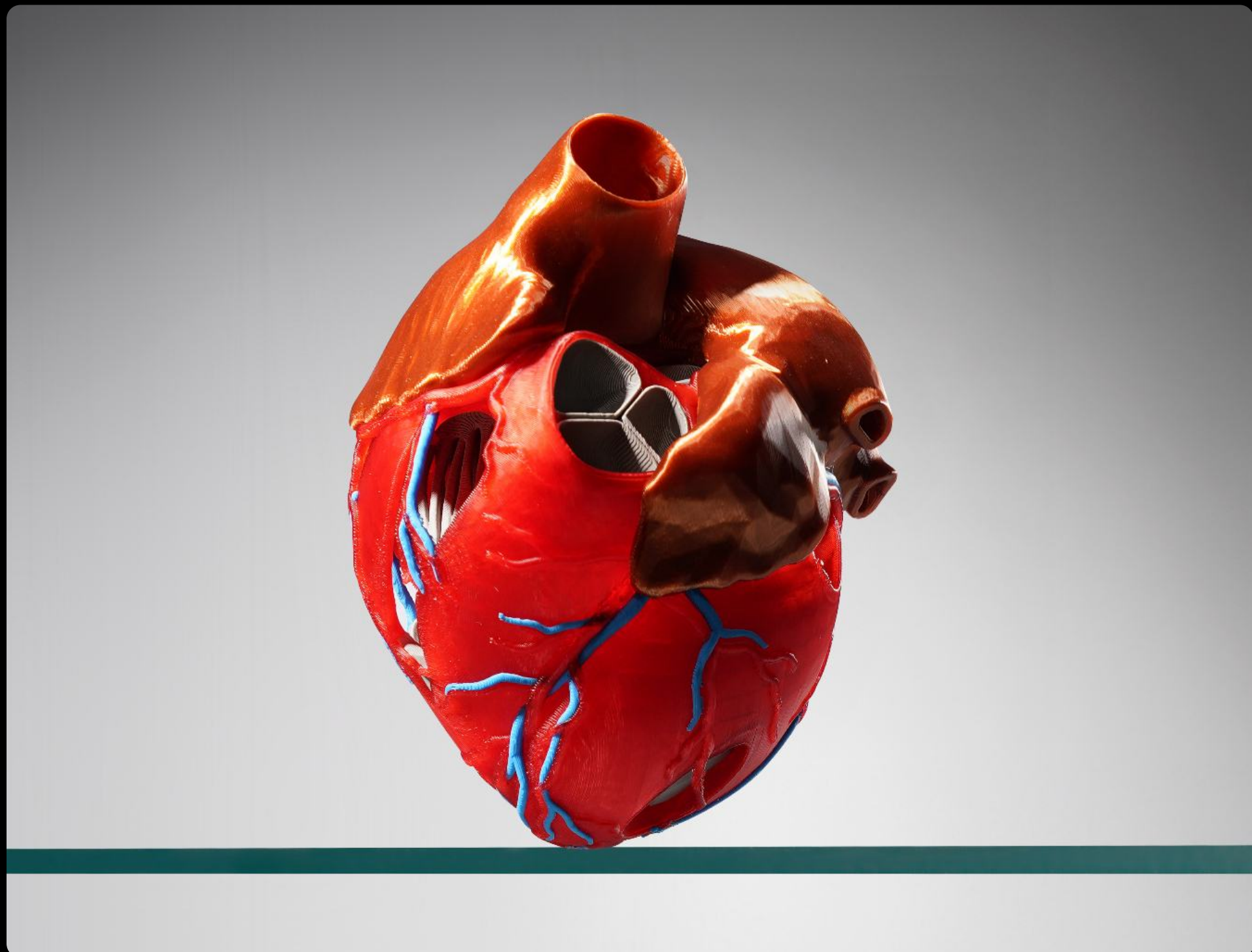
打印支撑更高效，支撑面更完美

打印支撑不再是难题。活用 H2D Pro 的双喷嘴配置，其中一个喷嘴可被支撑耗材打印，从而提升打印稳定性和支撑接触面质量。

高效多色打印

更快更省料的多色打印

双喷嘴打印可减少多色打印中的冲刷。H2D 的智能算法可计算最佳的耗材使用率，最大程度地提高双喷嘴效率，节省时间和材料。



专业级高温打印解决方案



工具头散热增强风扇

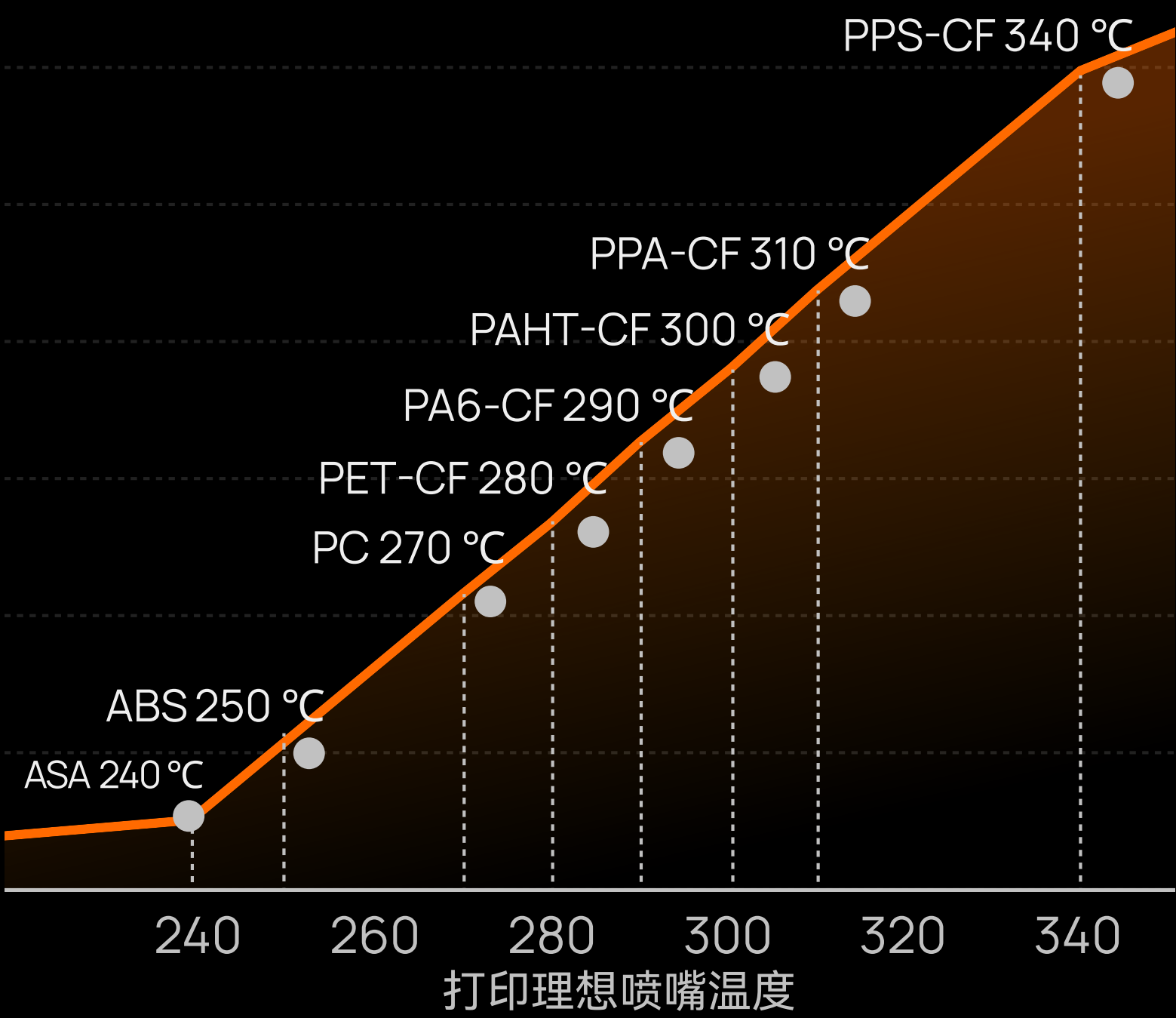
提高低软化温度耗材打印可靠性，避免堵头、挤出磨料

工具头前壳新增高性能离心风扇，带走挤出机和热端散热片的热量。通过智能温度控制，改善恶劣工况下可能带来的堵头和挤出阻塞，打印机建议工作环境温度提升3°C。

C高温热端

高性能耗材打印更从容

H2D Pro配备最高350°C的高温喷嘴，从容打印更多高性能耗材，如 PPA-CF/GF、PPS 和 PPS-CF。这些高性能耗材具备更稳定的机械强度与耐温性，为您的项目提供更多可能性。



65°C主动腔温加热及控制

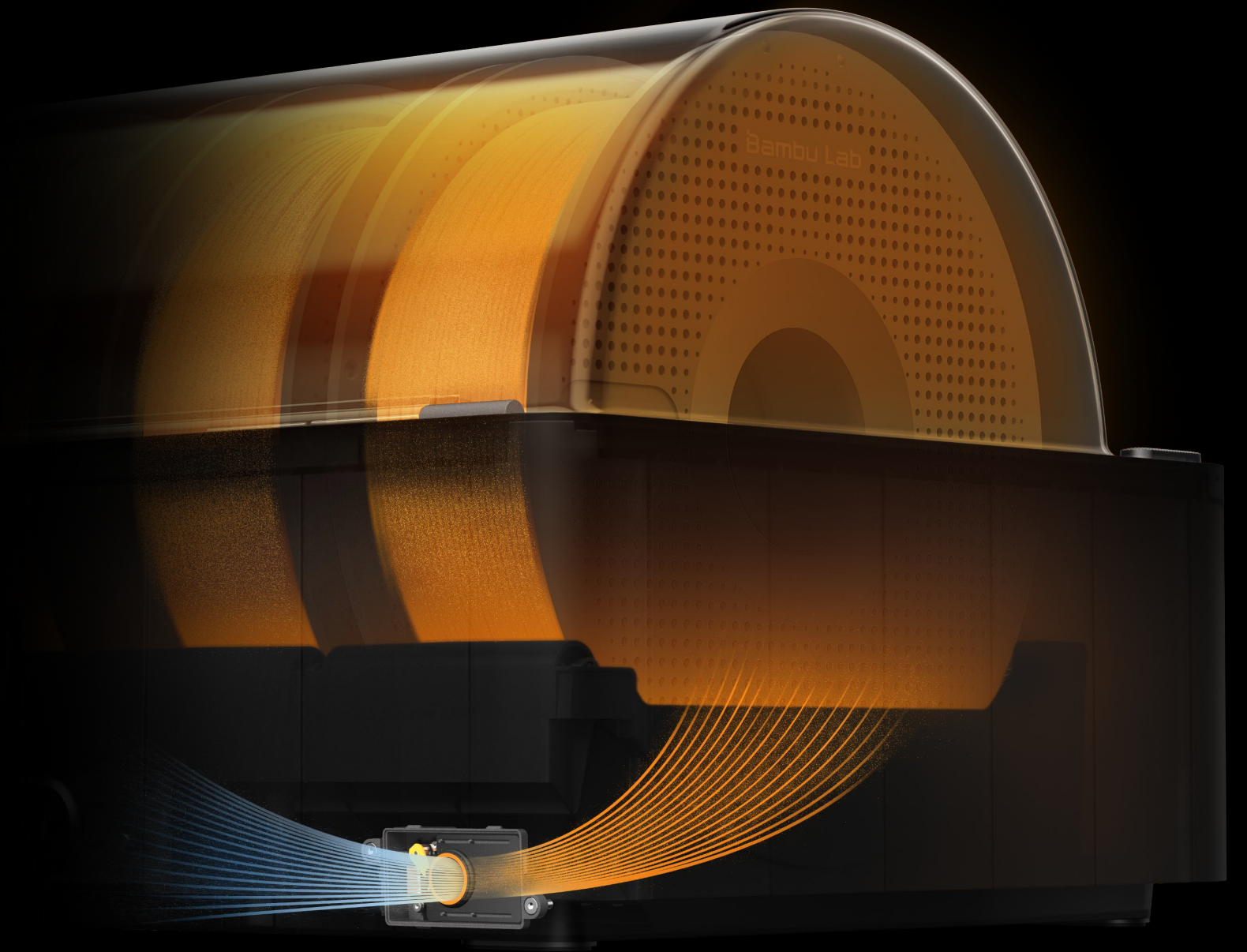
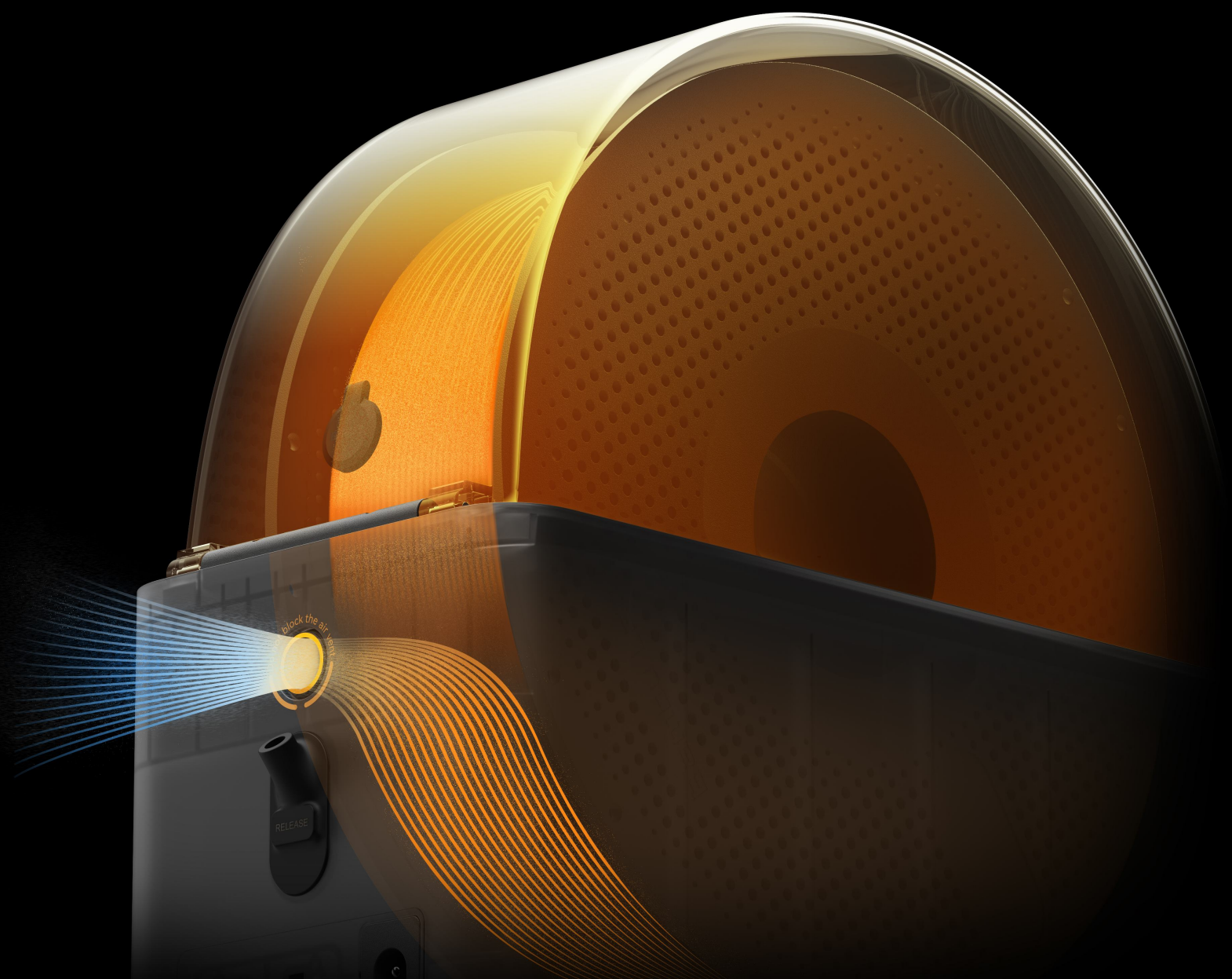
减少堵头、翘曲，增强层间结合力

H2D Pro配备 65°C 主动腔温加热和自适应空气循环。系统可通过主动风门控制内外循环智能切换，针对耗材类型智能控制打印腔温。这套先进机制可防止打印低温材料时堵头，抑制高性能材料的翘曲和变形、提升层间粘接，最大限度地发挥各类型耗材的优势。

第二代耗材管理系统

自动排湿料卷干燥

自动排湿有助于在干燥过程中进行除湿，并可实现数周的气密密封，确保高质量打印。

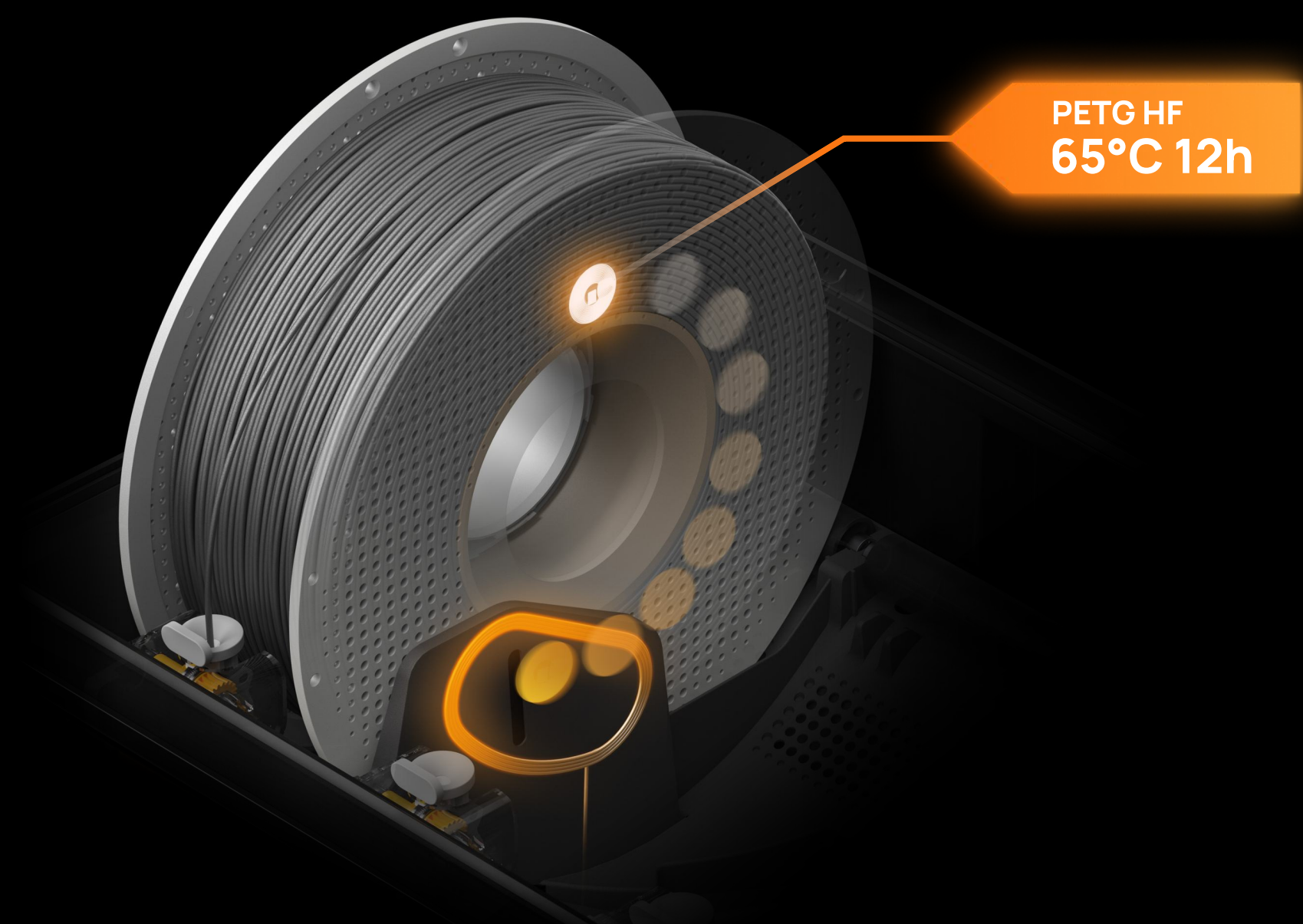


自动续料

打印永不中断，自动更换料，让您无需担心在睡觉或外出时耗尽耗材。

最高 85°C 干燥温度

AMS HT 的 85°C 干燥温度针对高温材料进行了优化。



RFID 同步

AMS 2 Pro/HT 使用 RFID 自动匹配 Bambu 官方耗材的类型、颜色和干燥设置，无需手动输入。

数项		参数
技术		熔融沉积型
机身	打印尺寸（长*宽*高）	单喷嘴模式：325*320*325 mm ³ 双喷嘴交集：300*320*325 mm ³ 双喷嘴并集：350*320*325 mm ³
	框架	铝材和钢材
	外壳	塑胶和玻璃
物理大小	外形尺寸	492*514*626 mm ³
	净重	31 kg
工具头	热端	全金属
	挤出机齿轮	硬化钢
	喷嘴	碳化钨
	喷嘴最高温度	350 °C
	默认自带喷嘴直径	0.4 mm
	支持喷嘴直径	0.2 mm、0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm
	工具头切刀	内置
	耗材直径	1.75 mm
	挤出电机	拓竹高精度永磁同步伺服电机
热床	打印板材质	弹性打印钢板
	默认自带打印板类型	纹理PEI打印板
	支持打印板类型	纹理PEI 打印板、光面PEI 打印板
	热床支持最高温度	120 °C
速度	工具头最大移动速度	1000 mm/s
	工具头最大移动加速度	20,000 mm/s ²
	热端最大流速	40 mm ³ /s（测试参数：单层外墙的 250 mm 圆形模型；拓竹 ABS；280 °C 打印温度）
腔温控制	主动腔温控制	支持
	最高可控腔温	65 °C
空气净化	初效过滤器等级	G3
	HEPA 滤网等级	H12
	活性炭滤芯类型	椰壳活性炭
	VOC过滤	出色
	颗粒物过滤	支持
冷却	部件冷却风扇	闭环控制
	工具头增强散热风扇	闭环控制
	热端风扇	闭环控制
	主控板风扇	闭环控制
	腔体外排风扇	闭环控制
	腔体加热循环风扇	闭环控制
	辅助部件冷却风扇	闭环控制

数项		参数
支持耗材类型	PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH	首推打印
	ABS、ASA、PC、PA、PET	出色打印
	碳纤/玻纤增强 PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA	出色打印
	PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF	适合打印
传感器	实况摄像头	内置；1920*1080
	喷嘴摄像头	内置；1920*1080
	工具头摄像头	内置；1920*1080
	开门检测	支持
	断料检测	支持
	缠料检测	支持
	耗材用量及余料检测	配合 AMS 使用时支持
	断电续打	支持
电源要求	电压	100–120 VAC / 200–240 VAC， 50/60 Hz
	最大功率*	2200 W@220 V / 1320 W@110 V
	平均功率	1050 W@220 V / 1050 W@110 V
电子元件	显示屏	5英寸 1280*720 触摸屏
	存储	内置8 GB EMMC，支持外挂U盘
	操作界面	触摸屏、手机端App、电脑端应用
	运动控制器	双核Cortex-M4处理器&单核Cortex-M7处理器
	应用处理器	四核 1.5 GHz ARM A7 处理器
	神经网络处理单元	2 TOPS
软件	切片软件	Bambu Studio 支持其他可导出标准 G 代码的第三方切片软件，如 SuperSlicer，PrusaSlicer和 Cura，但部分智能功能可能不支持。
	切片软件可支持操作系统	MacOS、Windows
网络连接	以太网	支持
	无线网络	Wi-Fi
	物理网络开关	支持
	可拆卸网卡	支持
	802.1X 认证	支持
Wi-Fi	工作频率	2412—2472 MHz, 5150—5850 MHz (FCC/CE) 2400—2483.5 MHz, 5150—5850 MHz (SRRC)
	Wi-Fi 发射功率 (EIRP)	2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
	Wi-Fi 协议	IEEE 802.11 a/b/g/n

* 为确保加热床快速达到所需温度，打印机将维持最大功率约3分钟。